

КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕЗОСТРУКТУР ТИПА СВЕРХПРОВОДНИК/НОРМАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛ

Кушнир В.Н.

The dependencies of the critical temperature on the thickness and on the number of layers for superconductor/normal metal multilayers (S/N) are calculated based on multimode solution of microscopic theory equations in diffusive limit. The finite transparency of S/N interfaces took into account. The theoretical curves reproduce satisfactory the experimental data.

Многослойные структуры типа сверхпроводник/нормальный металл (S/N) перспективны для использования в микроэлектронных устройствах [1,2]. Сверхпроводимость в S/N обусловлена эффектом близости, то есть проникновением (преимущественно диффузионным) куперовских пар из сверхпроводящего слоя в нормальный [3]. При этом толщина сверхпроводящего слоя d_S должна превосходить длину когерентности ξ_S сверхпроводящего материала. (Например, для структур Nb/Cu толщины слоев Nb составляют порядка 20 нм.) Исследование критического состояния предполагает определение термодинамических характеристик этого состояния (критической температуры T_c , верхних критических магнитных полей H_{c2} и т. д.) в зависимости от материальных параметров структуры – толщин слоев d_S , d_N , количества бислоев Nbl , длин свободного пробега электрона в металле l_S , l_N , скоростей Ферми v_{FS} , v_{FN} , плотностей числа состояний на уровне Ферми N_{FS} , N_{FN} . Кроме того, критические характеристики существенно зависят от параметров пограничных слоев между нормальными и сверхпроводящими слоями, в частности, от коэффициента квантовомеханического прохождения T (коэффициента прозрачности) потенциального барьера между сверхпроводящим (S) и нормальным (N) слоем. К настоящему времени достаточно подробно рассмотрены задачи об определении зависимостей $T_c(d_S)$, $T_c(d_N)$ в двух случаях: $Nbl = 1$ (трехслойная структура) и $Nbl = \infty$ (сверхрешетка) [2-6]. При этом при значениях коэффициента прозрачности $T < 1$ экспериментальные характеристики $T_c(d_S)$, $T_c(d_N)$ трехслойных структур моделируются обычно приближенными формулами теории S/N [7,8]. В данной работе получены точные матричные решения квазиклассических уравнений микроскопической теории S/N, на основе которых рассчитаны зависимости $T_c(d_S)$, $T_c(Nbl)$.

Рассматривается структура толщины L , состоящая из чередующихся плоских слоев сверхпроводящего и нормального металлов. Внешние слои структуры – из нормального металла. В соответствии с теорией S/N, их критическое состояние при отсутствии внешнего магнитного поля описывается интегральным уравнением Горькова [9] для параметра порядка $\Delta(z)$ ($z \in [0, L]$.) в следующей форме:

$$\Delta(z) = 4k_B T \cdot V(z) \sum_{\omega>0}^{\omega_D} \int_0^L dz' Q_{\omega}(z, z') \Delta(z') \quad (1)$$

Здесь T – температура, k_B – постоянная Больцмана; $\omega \equiv \omega(m) = \pi k_B T \cdot (2m + 1) / \hbar$ – мацубаровские частоты ($m = 0, 1, \dots, m_D$), ω_D – дебаевская частота, $m_D \equiv [\hbar \omega_D / 2\pi k_B T - 0.5]$.

$$V(z) = \begin{cases} 0, & z \in [l \cdot d, l \cdot d + d_N), l = 0, \dots, Nbl \\ V_S, & z \in (l \cdot d + d_N, (l+1) \cdot d], l = 0, \dots, Nbl - 1 \end{cases}$$

V_S – константа электрон-фононного взаимодействия, $d = d_S + d_N$;

Функции $Q_{\omega}(z, z')$, определяющие ядро интегрального уравнения (1), оказывается возможным задать обозримыми формулами в двух предельных случаях микроскопической теории: в т. н. «чистом» пределе (когда материалы сверхпроводящей структуры бездефектны), и в диффузионном пределе. Современные технологии приготовления сверхпроводящих структур таковы, что можно с достаточной уверенностью использовать диффузионный предел. В этом случае функции $Q_{\omega}(z, z')$ удовлетворяют дифференциальному уравнению [2,3]

$$\left(2\omega - D(z) \frac{d^2}{dz^2}\right) Q_{\omega}(z, z') = \frac{2\pi}{\hbar} N(z) \delta(z - z') \quad (2)$$

Здесь $D(z) = D_{S(N)}$ для $S(N)$ -слоев. Коэффициенты диффузии определяются через скорости Ферми и длины свободного пробега электрона: $D_{S(N)} = (1/3)v_{F,S(N)} l_{S(N)}$. Аналогично коэффициентная функция определяется через плотности числа состояний N_{FS}, N_{FN} на уровне Ферми.

Задача (1), (2) преобразуется к системе линейных обыкновенных дифференциальных уравнений (ЛОДУ) введением обозначения

$$\Delta_m(z) \equiv \int_0^L dz' Q_{\omega(m)}(z, z') \Delta(z') \quad (3)$$

Тогда вместо (2) получим

$$\left(m + \frac{1}{2} - \frac{\hbar D(z)}{4\pi k_B T} \frac{d^2}{dz^2}\right) \Delta_m(z) = N(z) V(z) \sum_{m'=0}^{m_D} \Delta_{m'}(z) \quad (4)$$

Система (4) дополняется естественными граничными условиями

$$\frac{d\Delta_m(0)}{dz} = \frac{d\Delta_m(L)}{dz} = 0 \quad (5)$$

Кроме граничных условий (5) система (4) должна быть дополнена условиями сшивания функций $\Delta_{\omega}(z)$ и их производных на плоскостях контакта S и N слоев, то есть в точках $z_{2k+1} = d_N + (k - 1)d$ и $z_{2k} = kd$ ($k = 1, \dots, Nbl$). Эти условия непосредственно следуют из условий Куприянова – Лукичева [10], полученных для «аномальных» функций Грина в диффузионном пределе:

$$D(z_i + 0) \frac{d\Delta_m(z_i + 0)}{dz} = D(z_i - 0) \frac{d\Delta_m(z_i - 0)}{dz} \quad (6.1)$$

$$D(z_i - 0) \frac{d\Delta_m(z_i - 0)}{dz} = \frac{v_{F,N} t_N N_{FN}}{2} \left(\frac{\Delta_m(z_i + 0)}{N(z_i + 0)} - \frac{\Delta_m(z_i - 0)}{N(z_i - 0)} \right) \quad (6.2)$$

В (6) t_N – параметр прозрачности границы, связанный с коэффициентом прозрачности оценочной формулой $t_N = T/(1 - T)$.

Поскольку коэффициентные функции в (4) – кусочно-постоянные, можем получить в явном виде общее решение задачи (4) – (6). Для этого строим точные решения для каждого из слоев структуры и сшиваем их посредством условий (6). Построив, таким образом, матрицант $\mathbf{R}(z)$ системы (4) [11], и используя далее граничные условия (5), получим систему алгебраических уравнений

$$\begin{pmatrix} \Delta(L) \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = \mathbf{R}(L) \begin{pmatrix} \Delta(0) \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \quad (7)$$

где вектор-функция $\Delta(z) \equiv (\Delta_0(z), \Delta_1(z), \dots, \Delta_{mD}(z), \Delta_0'(z), \Delta_1'(z), \dots, \Delta_{mD}'(z))^T$.

Из условия существования нетривиальных решений системы (7) определяется набор значений T , наибольшее из которых и есть критическая температура T_c .

Выражение для матрицанта $\mathbf{R}(L)$ через матрицанты $\mathbf{M}(d_N)$ и $\mathbf{S}(d_S)$ N - и S -слоев, и через матрицы \mathbf{P}_{NS} , \mathbf{P}_{SN} условий сшивания (6), имеет вид:

$$\mathbf{R}(L) = \mathbf{M}(d_N) [\mathbf{P}_{NS} \mathbf{S}(d_S) \mathbf{P}_{SN} \mathbf{M}(d_N)]^{Nbl} \quad (8)$$

Для матриц $\mathbf{M}(d_N)$ и $\mathbf{S}(d_S)$ имеют место следующие формулы:

$$\mathbf{M}(d_N) = \begin{pmatrix} \text{diag} \left[ch \left(\frac{d_N}{\xi_N^{(m)}} \right) \right] & \text{diag} \left[\xi_N^{(m)} sh \left(\frac{d_N}{\xi_N^{(m)}} \right) \right] \\ \text{diag} \left[\frac{1}{\xi_N^{(m)}} sh \left(\frac{d_N}{\xi_N^{(m)}} \right) \right] & \text{diag} \left[ch \left(\frac{d_N}{\xi_N^{(m)}} \right) \right] \end{pmatrix} \quad (9)$$

$$\mathbf{S}(d_S) = \begin{pmatrix} \mathbf{C} \text{diag} \left[ch \left(\frac{d_S}{\xi_S^{(m)}} \right) \right] \mathbf{C}^T & \mathbf{C} \text{diag} \left[\xi_S^{(m)} sh \left(\frac{d_S}{\xi_S^{(m)}} \right) \right] \mathbf{C}^T \\ \mathbf{C} \text{diag} \left[\frac{1}{\xi_S^{(m)}} sh \left(\frac{d_S}{\xi_S^{(m)}} \right) \right] & \mathbf{C} \text{diag} \left[ch \left(\frac{d_S}{\xi_S^{(m)}} \right) \right] \mathbf{C}^T \end{pmatrix} \quad (10)$$

В (9), (10) использованы следующие обозначения:

$$\xi_N^{(m)} = \xi_N^{(m)}(T) = \xi_N \sqrt{\frac{T_S}{(2m+1)T}}, \quad \xi_N \equiv \sqrt{\frac{\hbar D_N}{2\pi k_B T_S}} \quad (11.1)$$

$$\xi_S^{(m)} = \xi_S^{(m)}(T) = \xi_S \sqrt{-\frac{T_S}{2T\mu^{(m)}(T)}}, \quad \xi_S \equiv \sqrt{\frac{\hbar D_S}{2\pi k_B T_S}} \quad (11.2)$$

$m = 0, 1, \dots, m_D$.

В (11) температурные функции $\mu^{(m)}(T)$ есть корни характеристического уравнения

$$\psi \left(\frac{\omega_D}{2\pi k_B T} + 1 + \mu^{(m)}(T) \right) - \psi \left(\frac{1}{2} + \mu^{(m)}(T) \right) = \psi \left(\frac{\omega_D}{2\pi k_B T_S} + 1 \right) - \psi \left(\frac{1}{2} \right), \quad (12)$$

T_S – критическая температура сверхпроводящего материала, $\psi(x)$ – ди-гамма функция. Матрицы \mathbf{C} в (10) определяются выражениями

$$C_j^{(m)} = \frac{s^{(m)}}{j+1/2+\mu^{(m)}}, \quad s^{(m)} = \left[\sum_{j=0}^{mD} \frac{1}{(j+1/2+\mu^{(m)})^2} \right]^{-1/2} \quad (13)$$

и являются ортогональными: $\mathbf{C}^T \mathbf{C} = \mathbf{C} \mathbf{C}^T = \mathbf{1}$.

Матрицы «сшивания» определяются формулами:

$$\mathbf{P}_{SN} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \gamma_b \xi_N \mathbf{1} \\ 0 & p \mathbf{1} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}_{NS} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \gamma_b \xi_N p^{-1} \mathbf{1} \\ 0 & p^{-1} \mathbf{1} \end{pmatrix} \quad (14)$$

В (14) использованы параметры $p = \rho_S / \rho_N$, $\gamma_b = 2l_N / (3\xi_N t_N)$, где ρ_S , ρ_N – удельные сопротивления сверхпроводящего и нормального материалов, l_N – длина свободного пробега электрона в нормальном металле.

Задачу (7) – (14) в случае $Nbl = 1$ (трехслойная структура) можно привести к значительно более удобному для численного решения виду. Можно показать, что критическая температура в этом случае соответствует нулевому (одновременно минимальному) собственному значению матрицы

$$\mathbf{R} \mathbf{1} = \mathbf{S}_i(d_S/2) + p \frac{\mathbf{M}_i(d_N)}{1 + \gamma_b \xi_N \mathbf{M}_i(d_N)} \quad (15)$$

В (15) использованы следующие обозначения:

$$\mathbf{S}_i(d_S/2) = C \text{diag} \left[\frac{1}{\xi_S^{(m)}} \text{th} \left(\frac{d_S}{2\xi_S^{(m)}} \right) \right] \mathbf{C}^T, \quad \mathbf{M}_i(d_N) = \text{diag} \left[\frac{1}{\xi_N^{(m)}} \text{th} \left(\frac{d_N}{\xi_N^{(m)}} \right) \right]. \quad (16)$$

Выражение (15) позволяет сразу же получить одномодовое приближение для критической температуры, оправданное при значениях толщины S -слоя $d_S > \xi_S$. В этом приближении критическая температура находится из уравнений

$$\text{tg} \left(\frac{d_S}{2\xi_S} \sqrt{\frac{2T\mu(T)}{T_S}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2\mu(T)}} \frac{\gamma \cdot \text{th} \left(\frac{d_N}{\xi_N} \sqrt{\frac{T}{T_S}} \right)}{1 + \gamma_b \sqrt{\frac{T}{T_S}} \text{th} \left(\frac{d_N}{\xi_N} \sqrt{\frac{T}{T_S}} \right)} \quad (17)$$

$$\Psi \left(\frac{1}{2} + \mu(T) \right) - \Psi \left(\frac{1}{2} \right) = \ln \left(\frac{T_S}{T} \right) \quad (18)$$

где $\gamma = p\xi_S / \xi_N$, а из уравнения (18) находится наибольшее значение корня $\mu(T)$.

С помощью вышеизложенного метода были рассчитаны зависимости $T_c(d_S)$ S/N структур $Pd/Nb/Pd$ и $Cu/Nb/Cu$. Одна из таких зависимостей вместе с экспериментальным графиком [8] представлена на рисунке 1. Кроме того, по значениям параметров ρ_S , ρ_N , ξ_S , ξ_N взятым из эксперимента, и по найденному в результате фиттирования экспериментальных зависимостей параметру прозрачности, построены зависимости критической температуры от количества слоев. Результаты представлены на рисунке 2.

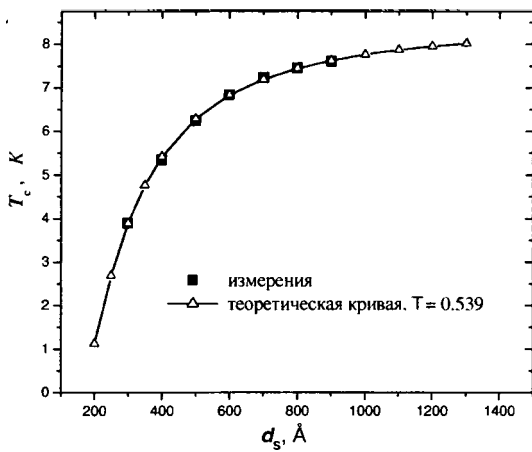


Рис.1. Экспериментальная и теоретическая зависимости $T_c(d_s)$ для структуры Pd/Nb/Pd.

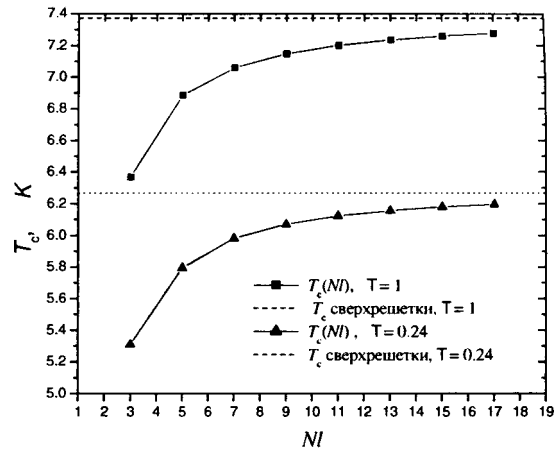


Рис.2. Зависимость критической температуры от количества слоев Nl структур Nb/Cu при двух значениях коэффициента прозрачности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Прищепа С.Л. // Доклады БГУИР. - 2004. Т. 3(7). – С. 118.
2. Jin B.I. and Ketterson J.B. // Adv. Phys. - 1989. Vol. 38. - P. 189.
3. Де Жен П. Сверхпроводимость металлов и сплавов. – М.: Мир, 1968. – 280с.
4. Lodder A. and Koperdraad R.P.W.// Physica C. - 1993. Vol. 212. - P. 81.
5. Koperdraad R.P.W. and A. Lodder // Phys. Rev. B. - 1995. Vol. 51. - P. 9026.
6. Brammertz G., A.A. Golubov, P. Verhoeve, R. Den Hartog, T. Peacock, H. Rogalla// Appl. Phys. Lett. – 2002. Vol. 80. – P. 2955.
7. Tesauro A., A. Aurigemma, C. Cirillo, S.L. Prischepa, M. Salvato and C. Attanasio // Supercond. Sci. Technol. - 2005. Vol. 18. - P. 152.
8. Cirillo C., S.L. Prischepa, M. Salvato and C. Attanasio // Euro. Phys. J. B - 2004. Vol. 38. - P.59.
9. Горьков Л. П. // ЖЭТФ. - 1959. Т. 37. - С.1407.
10. Куприянов М.Ю., В.Ф. Лукичев // ЖЭТФ. - 1988. Т. 94. - С. 139.
11. Якубович В.А., В.М. Старжинский. Линейные дифференциальные уравнения с периодическими коэффициентами и их приложения. - М.: Наука, 1972. – 588с.